

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Základní prvek modulárního krytu CH20M nabízí řadu výhod, které z něj činí vynikající volbu pro vaše typy použití. Díky speciálním výřezům pro sběrníkové kontakty a kontakty FE je obzvláště flexibilní a přizpůsobitelný.

Další výhodou je možnost laserového potisku krytu, který vám nabízí vysokou přesnost a individuální možnosti designu a konstrukce. K dispozici je také široká škála barev, díky nimž si pouzdro můžete navrhnout zcela podle svých představ.

Pouzdro CH20M je také vhodné pro standardní montážní lišty, což usnadňuje instalaci a integraci do stávajících systémů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montážní lišty, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Boční prvek, příprava spojení mikro-SIM karta (3FF), Šířka: 45 mm
Číslo objednávky	2738670000
Typ	CH20M45 B SIM BK/BK 2010
GTIN (EAN)	406467506409 1
Množství	6 items

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	108 mm	Hloubka (v palcích)	4.252 inch
Výška	109.3 mm	Výška (v palcích)	4.3031 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	36.53 g		

Teploty

Okolní teplota	-25 °C...85 °C	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66 GF 30
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Plast	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

Vlastnosti sestavy

Počet slotů pro zásuvky namontované sestavy, max.	12	Počet PCB, max.	2
Počet úrovní připojení, max.	3	Počet pólů, max.	48
Výška komponentů na PCB (použití 1 PCB), max.	38.6 mm	Výška komponentů na PCB (použití 2 PCB), max.	34.7 mm
Typ sestavy desky plošných spojů	dvoustranný		

Mechanické testy

Podle normy	DIN EN 61373:1999 (nárazy a vibrace)	
Zkušební podmínky	pět krytů instalovaných v řadě, dodatečná hmotnost 200 g na DPS, dvě namontované DSP	
Osvědčené osy	X, Y, Z	
Nárazový test	Obecné testovací rady	Všechny mechanické testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
	Zkušební kategorie	1
	Počet nárazů na osu	3in pozitivní a negativní směr
	Trvání nárazu	30 ms
	Zrychlení horizontální	30.00 m/s ²
	Zrychlení vertikální	30.00 m/s ²
	Zrychlení podélné	50.00 m/s ²
Vibrační test	Zkušební kategorie	1B
	Trvání zkoušky	5 hodin na osu
	Efektivní zrychlení	7.9 m/s ²

Technické údaje

Tepelné testy

Tepelné zkoušky	Obecné testovací rady	Všechny tepelné testy byly vyzkoušeny na vzorovém nastavení nebo z pohledu závislé regulace. Uvedené výsledky nenahrazují příslušné schvalovací testy. Jsou to jen orientační hodnoty.
	Zkušební podmínky	sedm krytů instalovaných v řadě – bez rozestupu
	Zkušební osy	vodorovné
	Okolní teplota	55 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	4.2 W
	Okolní teplota	50 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	4.8 W
	Okolní teplota	40 °C
	Rozptýlení výkonu, max.	5.9 W
	Okolní teplota	20 °C
Rozptýlení výkonu, max.	8.25 W	

Vlastnosti komponenty

Barva připínací patky	černá	Výřez v ploše připínací patky jako příprava pro	Karta Micro SIM (3FF)
Počet úrovní připojení, max.	3		

Typ konstrukce - požadavky IN

Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm	PCB thickness	1.6 mm
Tolerance of circuit board thickness	±0,15 mm		

Individualizační možnosti

Možná značení na míru	Ano	Proces objednávky specifický pro zákazníka	Viz pokyny pod zátěží
Alternativní barvy	Více na vyžádání	Možnosti zpracování	Zpracování laserem

Obecné údaje

Barevný	černá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 9011
Encapsulation option	Ne		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů.
----------------------	--

Klasifikace

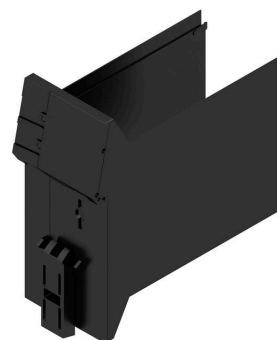
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Nákresy

Obrázek výrobku



Výhoda produktu



Basiselement einschließlich SIM-Ausschnitt

Rozměrový výkres

